

未 來 計 劃 及 [編 纂] 用 途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳情，請參閱「業務 — 我們的增長戰略」。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的中位數)，經扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]及其他估計開支後，我們估計將自[編纂]收取[編纂]淨額約[編纂]港元(假設[編纂]未獲行使)。為配合我們的戰略，我們擬將[編纂]淨額作以下用途及按下列金額分配：

- 約[編纂]%(或約[編纂]港元)預期將用於建設新設施及升級我們現有的生產設施及產線，包括：
 - 約[編纂]%(或約[編纂]港元)預期將用於支持我們中國內地生產設施的高速EML芯片及光模塊的產能擴張，以把握AI基礎設施建設帶來的市場需求。具體而言，約[編纂]%(或約[編纂]港元)預期將用於購置光模塊生產設備，目標年產能約為24百萬台；約[編纂]%(或約[編纂]港元)預期將用於購置光芯片生產設備，目標年產能約為10億台；以及約[編纂]%(或約[編纂]港元)預期將用於工廠建設及翻新工程。通過向光模塊業務提供資金支持，我們將強化其業務運營與供應鏈，提升其產能建設及規模化交付能力，並鞏固其在高端光模塊市場的領先地位。
 - 約[編纂]%(或約[編纂]港元)預期將用於在珠海為超毅建設專注於高端PCB的新生產設施。我們預計將採購新製造設備以強化基礎設施，主要包括鑽孔機、曝光機及電鍍機，以支持先進PCB的製造。該投資預計將在兩年內每年部署約[編纂]%的資金。我們預計分兩期完成新增產能的部署，一期已於2026年9月投產，二期將於2027年第二季度投產。根據現有主要客戶的訂單以及我們對市場需求的評估，我們預期新產能在全面量產後可達到100%的使用率。

此項投資將解決供應缺口問題，並透過提高高層數硬板及高階HDI等高端PCB的比例，進一步提升我們的產品組合，這與我們致力於高端製造能力的承諾一致。我們相信，這將使我們能夠滿足市場對高密度、高速PCB的中長期需求及客戶需求，優化我們的產品組合，滿足日益增長的AI計算需求。

我們已取得項目所需的審批，並符合適用的行業監管要求。一期已於2026年9月投產，且二期已根據所有適用法律法規取得所有關鍵審批文件。截至最後實際可行日期，我們已為一期項目的土地購置、工廠建設及設備採購投資約837.7百萬港元，並已為二期項目投資約1,957.4百萬港元。

未 來 計 劃 及 [編 纂] 用 途

- 約[編纂]% (或約[編纂]港元)預期將用於升級及加強我們在中國的生產設施。具體而言，我們計劃優化製造執行系統與質量管理體系，進行額外軟件升級，以支持我們在中國生產設施的智能製造系統。

我們預計將採購智能CNC機床、工業機器人、視覺檢測系統及5G工業模組，以進一步提升我們在高層數硬板的製造效率及自動化水平。具體而言，約[編纂]% (或約[編纂]港元)預期將用於硬件升級，包括生產設備、數據採集系統及基礎設施；約[編纂]% (或約[編纂]港元)預期將用於軟件及服務投資，包括核心軟件、技術服務及支持服務。我們預計在兩年內分階段投入該等投資，第一年使用總額約[編纂]%，第二年使用約[編纂]%。根據我們目前對市場需求的評估，我們預期該等舉措將進一步提升我們在AI PCB的生產能力及製造能力。該等改進措施將有助於在整個生產流程中實現更佳的數據整合，提升營運效率、改進良率管理。最終，該等舉措將強化供應鏈韌性，提升我們的服務能力。

該等投資將使我們能夠緊貼客戶需求，透過將資源集中於高增長產品，把握AI驅動的需求以擴大我們的產品組合，並鞏固在全球一線客戶供應鏈中的地位。在完成全部投資並實現全面量產後，我們的PCB生產預計將達到約636.0千平方米的設計年產能。

- 約[編纂]% (或約[編纂]港元)預期將用於潛在戰略投資或收購，以鞏固我們核心業務的技術領先地位及市場領先地位。我們可能在PCB、精密組件及光模塊行業的價值鏈中，選擇性地進行股權投資或收購。評估潛在標的時，我們將主要關注以下因素：(i)與我們核心產品線及終端市場的戰略契合度，以及標的能在多大程度上增強我們的關鍵能力；(ii)具備強大技術護城河，包括專有技術、差異化工藝能力、專利或其他市場進入壁壘；(iii)產品與市場高度契合，並輔以具競爭力且可擴展的產品路線圖；(iv)可驗證且持續的客戶需求，需具備成熟客戶關係或知名客戶的認證資格狀態，這有望促進交叉銷售並深化客戶滲透率；(v)運營質量與擴展性，涵蓋製造成熟度、良率與質量體系、供應鏈韌性及產能擴張潛力；(vi)整合可行性與執行風險，包括文化契合度、管理深度及運營、系統與管治的整合難易度；(vii)市場規模與成長潛力，優先考慮在終端市場經營、可觸及市場總規模至少達100億美元且具備穩定增長往績記錄的標的；以及(viii)財務可持續性與回報情況，包括最近三個財政年度的經營現金流量為正且足以支付維護性資本支出、未來五年的預估現金流量足以償付及清償債務，以及預期投資回收期不超過五年。對於我們認為對本公司的長期發展具有重大戰略意義的標的，上述財務標準可作調整。根據灼識諮詢的資料，截至最後實際可行日期，共有約100至150個潛在收購目標。灼識諮詢使用行業協會數據及公開可得的商業註冊記錄，識別PCB、精密組件及光模塊行業內的公司，按年收入對該等公司分類，並根據收購估值標準進行篩選。通過與高級行業專家進行訪談、對供應鏈各環節交叉驗證及向行業協會諮詢，灼識諮

未 來 計 劃 及 [編 纂] 用 途

詢確認，其餘公司均與本集團核心業務具有真正的戰略協同效應，擁有穩固的技術壁壘，且具備潛在的可收購性。

截至最後實際可行日期，我們尚未物色任何特定目標，亦未訂立任何最終協議。

- 約[編纂]% (或約[編纂]港元) 預期將用於償還部分現有債務，包括：
 - 未償還貸款結餘人民幣330.0百萬元，該貸款用於為鹽城東創位於鹽城的精密組件生產設施第一期建設提供資金，到期日為2027年12月20日，年利率為一年期貸款市場報價利率(LPR)減45個基點；
 - 未償還貸款結餘人民幣317.0百萬元，該貸款用於為鹽城東創位於鹽城的精密組件製造生產設施第二期建設提供資金，到期日為2028年12月21日，年利率為一年期貸款市場報價利率(LPR)減45個基點；
 - 未償還貸款結餘人民幣440.0百萬元，該貸款用於為蘇州東越位於蘇州的精密製造設施第一期建設提供資金，到期日為2030年4月6日，年利率為五年期以上貸款市場報價利率(LPR)減100個基點；及
 - 未償還貸款結餘人民幣293.0百萬元，該貸款用於為蘇州東越位於蘇州的精密製造生產設施第二期建設提供資金，到期日為2034年6月4日，年利率為五年期以上貸款市場報價利率(LPR)減110個基點。
- 約[編纂]% (或約[編纂]港元) 預期將用作營運資金及一般企業用途。

倘[編纂]定為指示性[編纂]範圍的最高[編纂]或最低[編纂]，[編纂]的[編纂]淨額將分別增加或減少約[編纂]港元 (假設[編纂]未獲行使)。我們擬按比例將增加或減少的[編纂]淨額用於上述用途。

倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取的額外[編纂]淨額將為(i)[編纂]港元 (假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即最高[編纂])、(ii)[編纂]港元 (假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即[編纂]範圍的中位數) 及(iii)[編纂]港元 (假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即最低[編纂])。倘[編纂]的[編纂]淨額 (包括行使[編纂]的[編纂]淨額) 多於或少於預期，我們可能會按比例調整我們就上述用途對[編纂]淨額的[編纂]。

倘我們發展計劃的若干部分因政府政策變動或不可抗力事件等因素而受阻，我們的董事將審慎評估情況，並可能[編纂][編纂]的[編纂]淨額。倘[編纂]的擬定用途有任何重大變動，我們將根據香港上市規則作出適當披露。

倘[編纂]的[編纂]淨額未能即時用於上述用途，我們僅會將該等資金存入持牌商業銀行及／或其他認可金融機構 (定義見證券及期貨條例或其他司法管轄區的適用法律法規) 的短期計息賬戶。在該等情況下，我們將遵守香港上市規則下的適當披露規定。